正本

檔　　號：
保存年限：

國家科學及技術委員會　函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：江紹平
電話：02-2737-8050(葉麟)
傳真：(02)2737-7619
電子信箱：linyeh@nstc.gov.tw

受文者：國立嘉義大學

裝

發文日期：中華民國115年10月28日
發文字號：科會自字第1150075406號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：本會與台灣積體電路製造股份有限公司合作公開徵求116年度「臺灣地質碳封存潛力場域調查研究」構想書，自即日起受理申請，請於115年11月17日前備函至本會提出，以郵戳為憑，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

訂

一、本計畫徵求說明請詳閱附件，或至本會網站(動態資訊/計畫徵求專區)、自然科學及永續研究發展處公告網頁下載。

二、本次徵案採兩階段辦理，第一階段請提案機構於本徵案說明所載公告日期次日起20日內(即115年11月17日前，以郵戳為憑)，備函檢附構想書至本會辦理。構想書需含全部內容電子檔，得以有效之下載鏈結、儲存於實體裝置(如光碟、USB隨身碟)等方式提供，實體裝置於審查作業結束後不予歸還。

三、構想書經書面審查獲推薦通過者，本會將另案通知完整計畫書之繳交期限。如發現不同提案之研究內容具高度關聯性或資源共享效益，本會得要求相關提案機構合併組成計畫團隊，並提出整合後之完整計畫書。

線

四、本計畫係屬本會與企業合作專案，凡審查未獲通過者，本會恕不提供申覆機制。

正本：經濟部、環境部、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、駐外單位（共18單位）、專題研究計畫受補助單位（共274單位）
副本：台灣積體電路製造股份有限公司、本會綜合規劃處、科教國合處、前瞻應用

電子公文交換章

國立嘉義大學 115/10/28
1150016306

處、產學園區處、國會聯絡組、新聞組、自然處(均含附件)

電子公文
交換章